

2012年3月期 決算説明会

2012年5月1日

東京エレクトロン デバイス株式会社



東京エレクトロン デバイス株式会社

2012年3月期 決算報告

代表取締役副社長 久我 宣之

事業譲受け完了について

連結子会社パネトロン株式会社の事業譲受け(2011年11月7日発表)が下記の通り完了

1. 譲受け内容

株式会社アムスクより、
テキサス・インスツルメンツ社製品の販売代理店事業

2. 譲受け日

2012年4月1日

3. 譲受け価額

1,097百万円

内訳⇒たな卸資産:583百万円 のれん:514百万円

4. 受け入れ従業員

35名を当社グループで雇用(4月1日付)

2012年3月期 連結業績

(単位:百万円)

	2011年3月期		2012年3月期		増減率 (%)
		百分比%		百分比%	
売上高	91,315	100.0	86,300	100.0	▲5.5
売上総利益	16,168	17.7	15,354	17.8	▲5.0
営業利益	2,745	3.0	2,011	2.3	▲26.7
経常利益	2,941	3.2	2,332	2.7	▲20.7
当期純利益	1,918	2.1	960	1.1	▲49.9
1株当たり当期純利益	18,095.67円		9,064.37円		
R O E	8.5%		4.1%		
1株当たり年間配当金	6,600円		6,600円		
期末従業員数	880人		900人		

連結業績を下方修正

(単位:百万円)

	2011.10.27 発表 (A)	2012.1.30 発表 (B)	増減額 (A)-(B) 増減率 (%)	2012年3月期 実績 (C)	増減額 (C)-(B) 増減率 (%)
売上高	88,000	85,000	▲3,000 ▲3.4	86,300	1,300 1.5
営業利益	2,375	1,700	▲675 ▲28.4	2,011	311 18.3
経常利益	2,750	2,100	▲650 ▲23.6	2,332	232 11.1
当期純利益	1,560	850	▲710 ▲45.5	960	110 13.0

2012年3月期 連結資産

(単位:百万円)

科目	2011年3月期	2012年3月期	増減額
現預金	1,373	1,264	▲108
受取手形・売掛金	21,025	20,434	▲590
たな卸資産	19,347	16,681	▲2,666
その他流動資産	3,505	3,389	▲115
有形固定資産	1,469	1,254	▲215
無形固定資産	390	429	38
投資その他の資産	3,143	2,936	▲206
資産計	50,254	46,391	▲3,863

2012年3月期 連結負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2011年3月期	2012年3月期	増減額
買掛金	7,360	5,915	▲1,445
短期借入金	7,996	4,402	▲3,593
その他流動負債	5,923	6,567	643
固定負債	5,753	6,122	369
負債計	27,034	23,009	▲4,024
資本金	2,495	2,495	—
資本剰余金	5,645	5,645	—
利益剰余金	15,238	15,467	229
その他包括利益累計額	▲158	▲226	▲68
純資産計	23,220	23,381	161
負債・純資産計	50,254	46,391	▲3,863

2012年3月期 連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2011年3月期	2012年3月期	要 因
営業キャッシュ・フロー	▲1,877	4,602	売上債権減少 たな卸資産減少
投資キャッシュ・フロー	▲676	▲383	ソフトウェアライセンス料 検査用備品 事務所増床
財務キャッシュ・フロー	2,321	▲4,330	配当金支払い 短期借入金返済
現金及び現金同等物 期末残高	1,373	1,264	

セグメント別 連結売上高・利益

(単位:百万円)

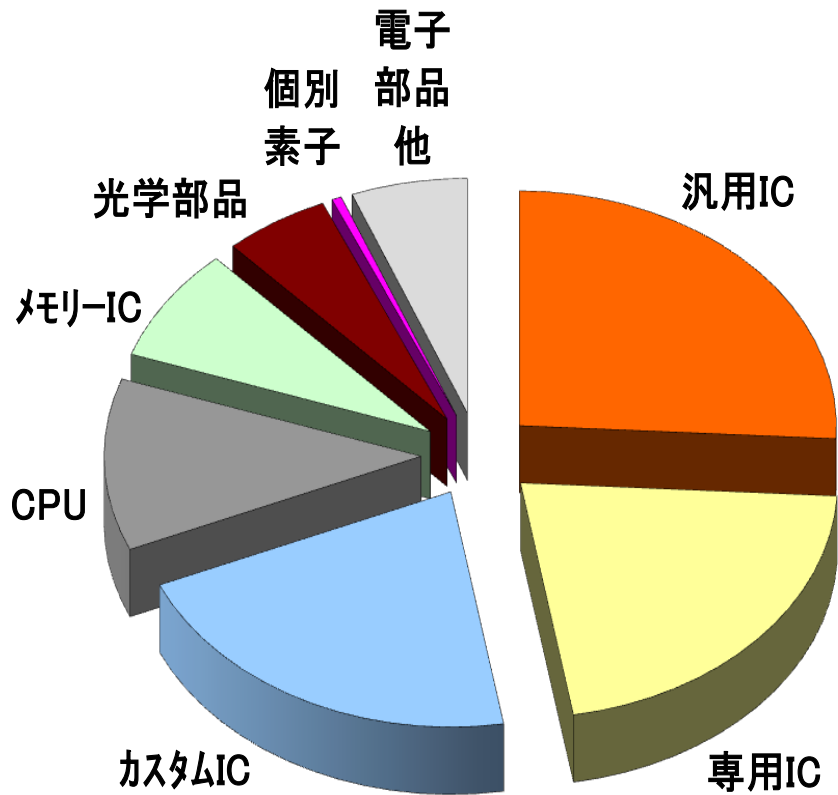
セグメント	2011年3月期		2012年3月期			
	売上高	セグメント利益	売上高	増減額 増減率 (%)	セグメント利益	増減額 増減率 (%)
半導体及び 電子デバイス事業	73,354	2,089	67,699	▲5,654 ▲7.7	1,094	▲994 ▲47.6
コンピュータ システム関連事業	17,961	852	18,600	638 3.6	1,238	385 45.2
合 計	91,315	2,941	86,300	▲5,015 ▲5.5	2,332	▲608 ▲20.7

半導体及び電子デバイス事業

品目別 売上構成

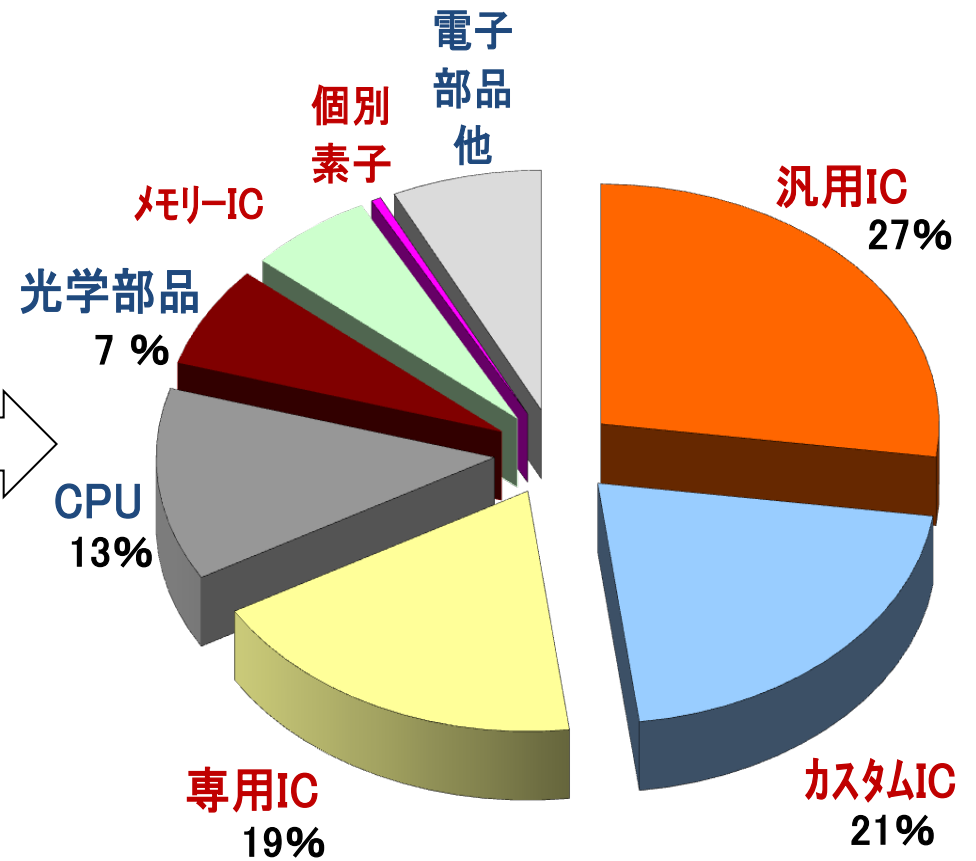
【 2011年3月期 内訳 】

売上高： 73,354百万円



【 2012年3月期 内訳 】

売上高： 67,699百万円



* 品目についての説明は、P.42～ P.43をご参照ください。

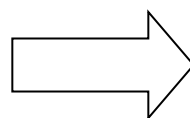
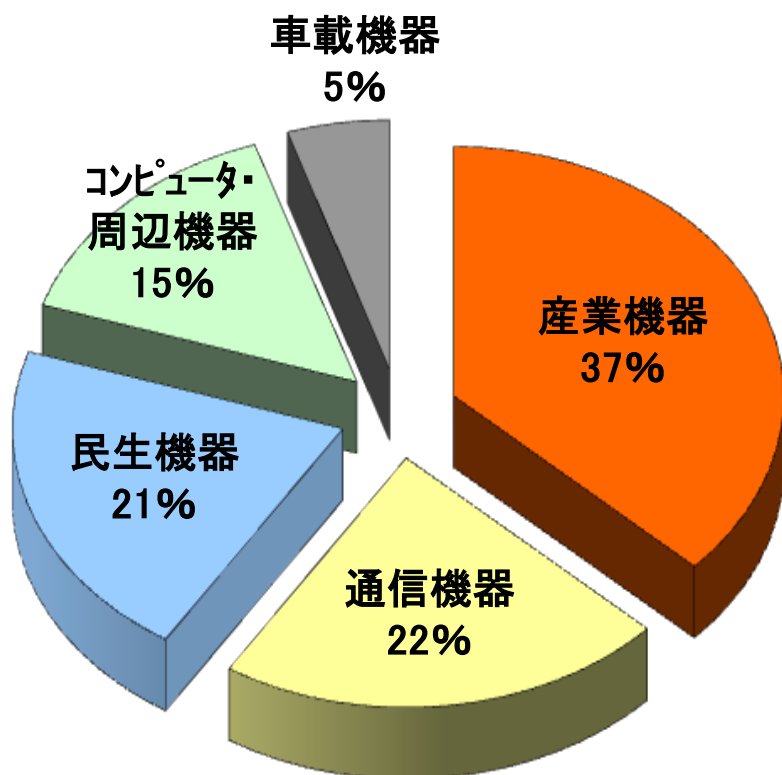
半導体及び電子デバイス事業
主な品目別 売上増減

品目	主な仕入先	対前年増減率	主な要因
汎用IC	リニアテクノロジー、TI	▲3%	商権移管あり基地局増加も 産業機器、民生機器減少
カスタムIC	ザイリンクス、富士通セミコンダクター	▲9%	複合プリンター増加も 民生機器、産業機器減少
専用IC	ピクセルワークス、ピクシスシステムズ、 富士通セミコンダクター、TI、 シリコンイメージ	▲20%	液晶プロジェクタ堅調も 薄型TV、AVアンプ等民生機器減少
CPU	フリースケール、TI	1%	カーナビゲーション増加
光学部品	アバコ・テクノロジー	16%	スマートフォン増加

注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

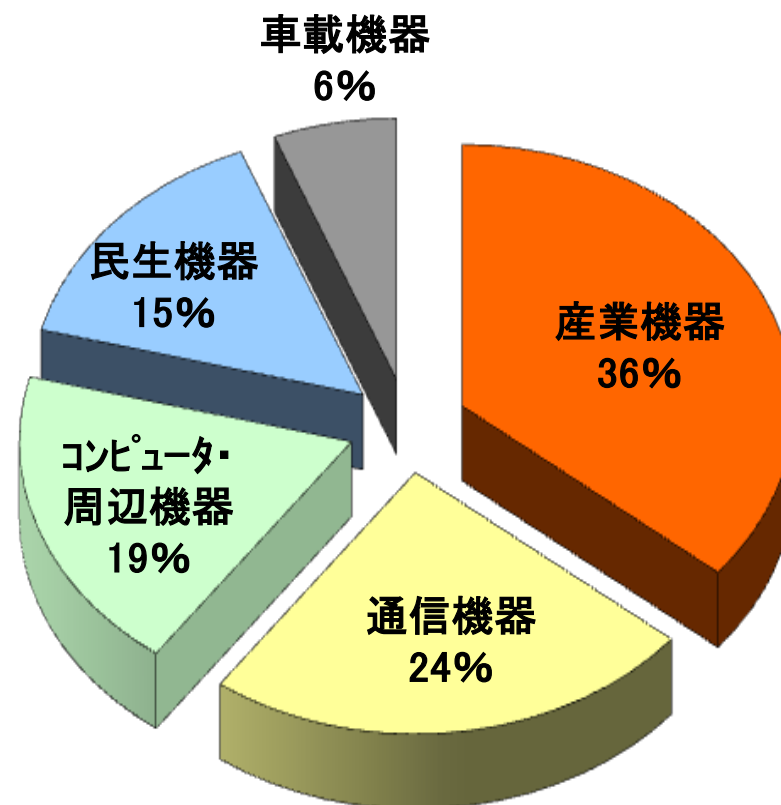
【 2011年3月期 内訳 】

売上高： 73,354百万円



【 2012年3月期 内訳 】

売上高： 67,699百万円



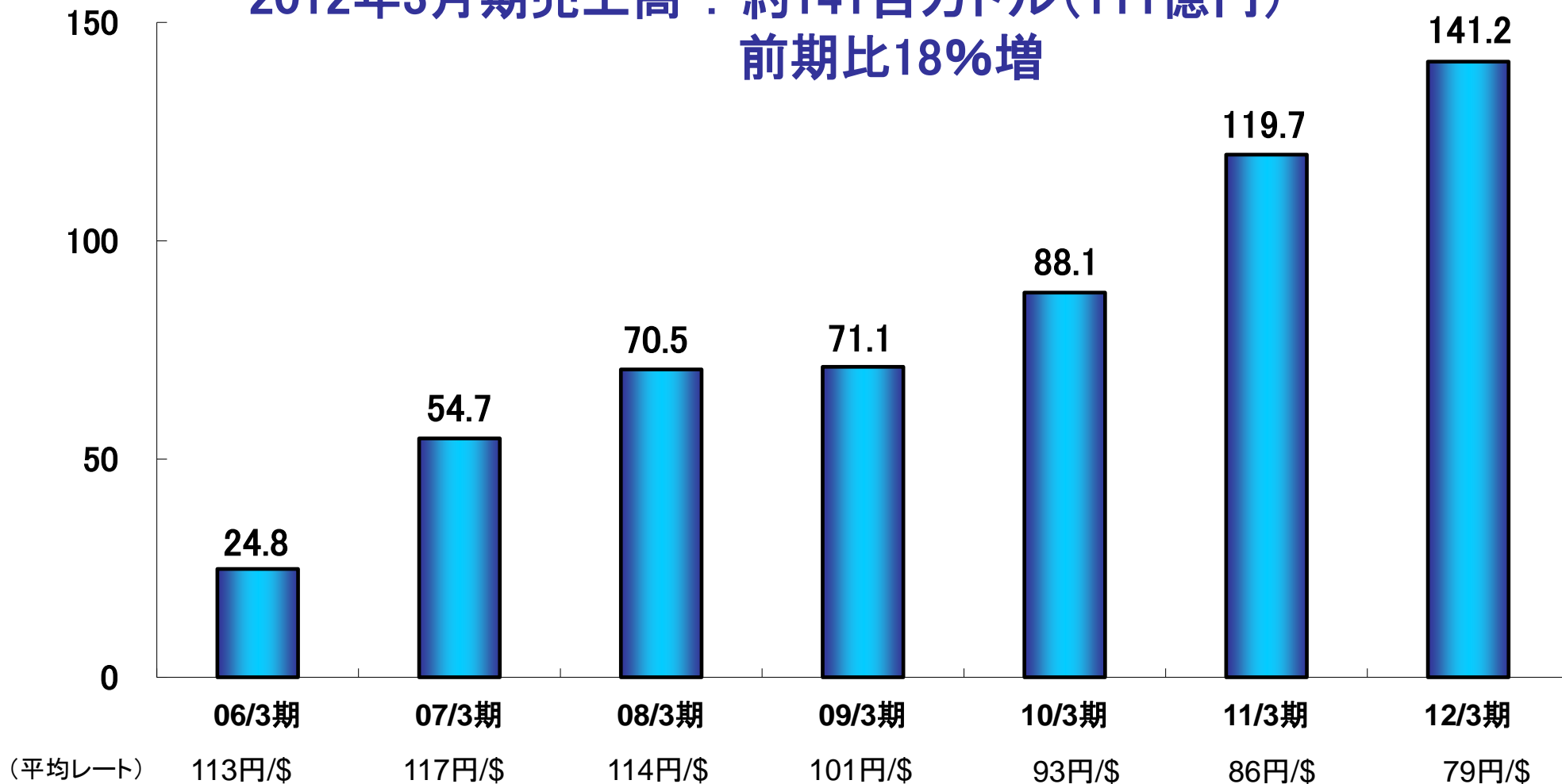
用途別 傾向

用途	主なアプリケーション	当社の傾向
産業機器	医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置、ロボット、計測器	全般的に上期堅調も下期低調 汎用IC、カスタムIC減
通信機器	基地局、ルーター、伝送装置、携帯電話、スマートフォン	基地局堅調、汎用IC増 携帯電話不調、メモリーIC減 スマートフォンは好調、光学部品増
コンピュータ・周辺機器	複合プリンター、液晶プロジェクタ、PC及び付属機器	液晶プロジェクタ堅調、専用IC増 複合プリンター下期好調、カスタムIC増
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	震災やタイ洪水の影響もありTVを中心に大幅減、専用IC、メモリーIC、カスタムIC、汎用IC減
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	カーナビゲーション下期好調、CPU増

【 海外連結子会社 売上高推移 】

(US\$M)

2012年3月期売上高：約141百万ドル(111億円)
前期比18%増



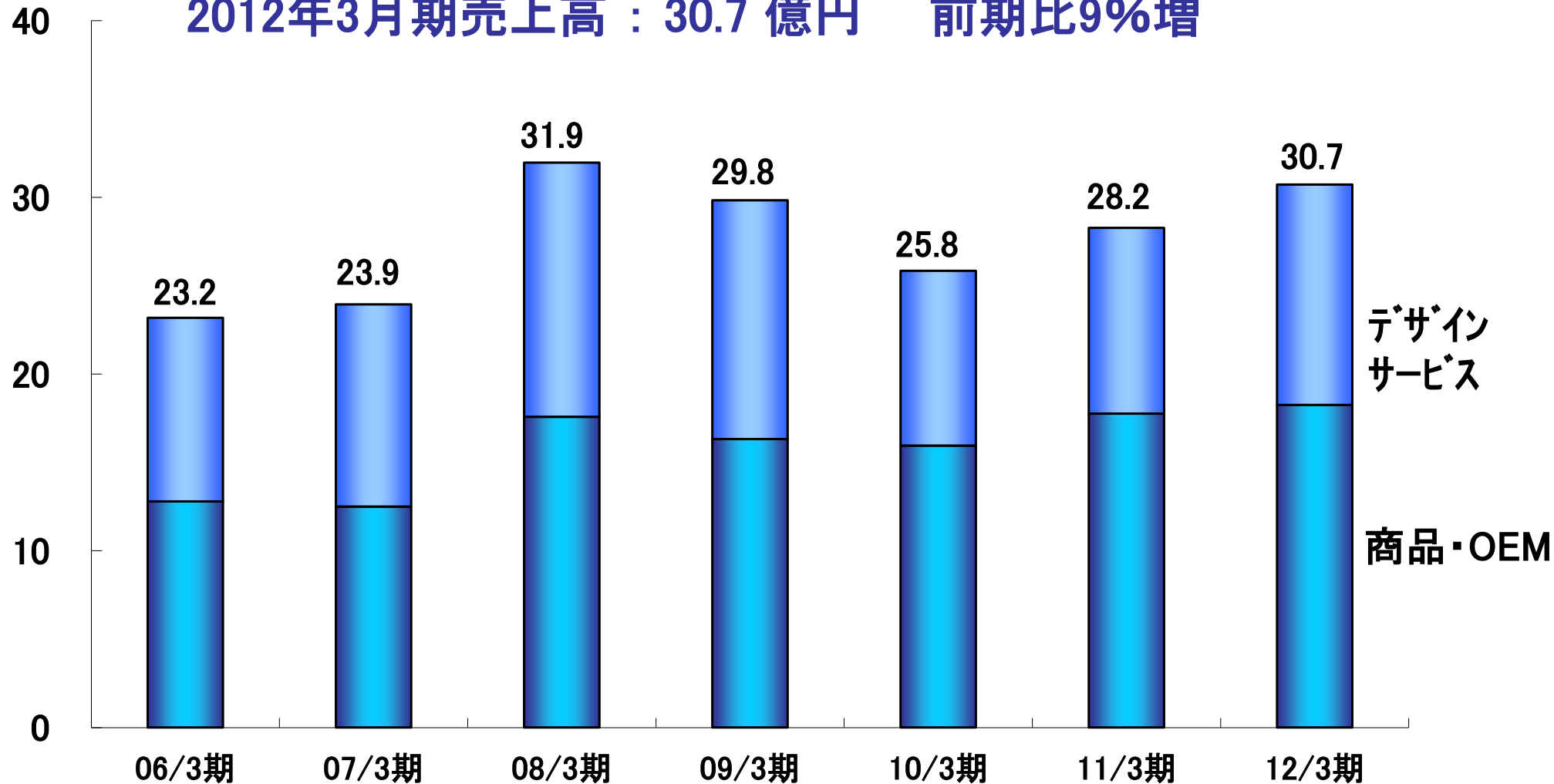
◆ メーカー機能への取り組み



【 インレビウム 売上高推移 】

(億円)

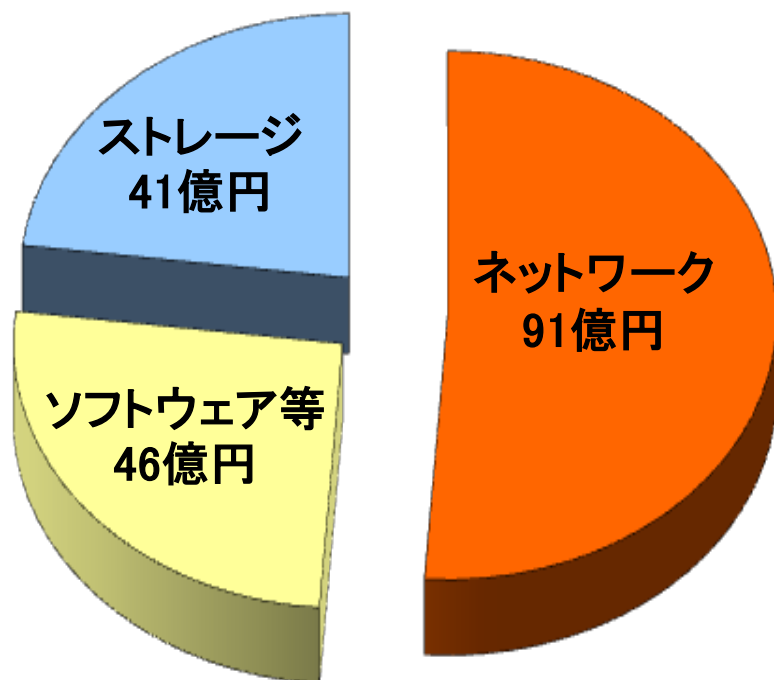
2012年3月期売上高 : 30.7 億円 前期比9%増



コンピュータシステム関連事業

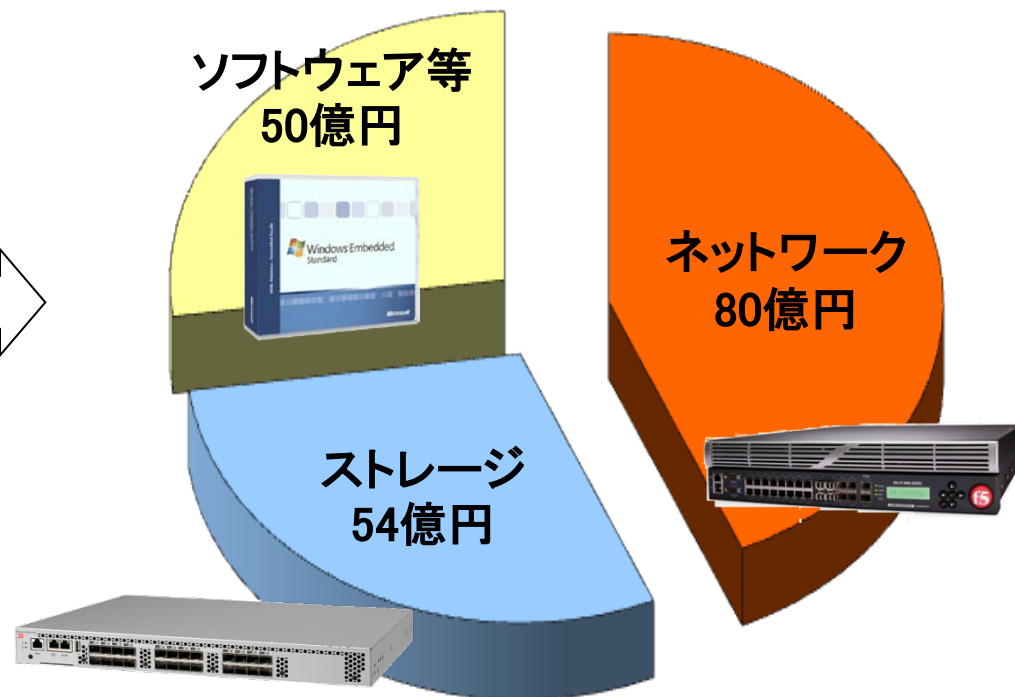
【 2011年3月期 内訳 】

売上高: 17,961百万円



【 2012年3月期 内訳 】

売上高: 18,600百万円

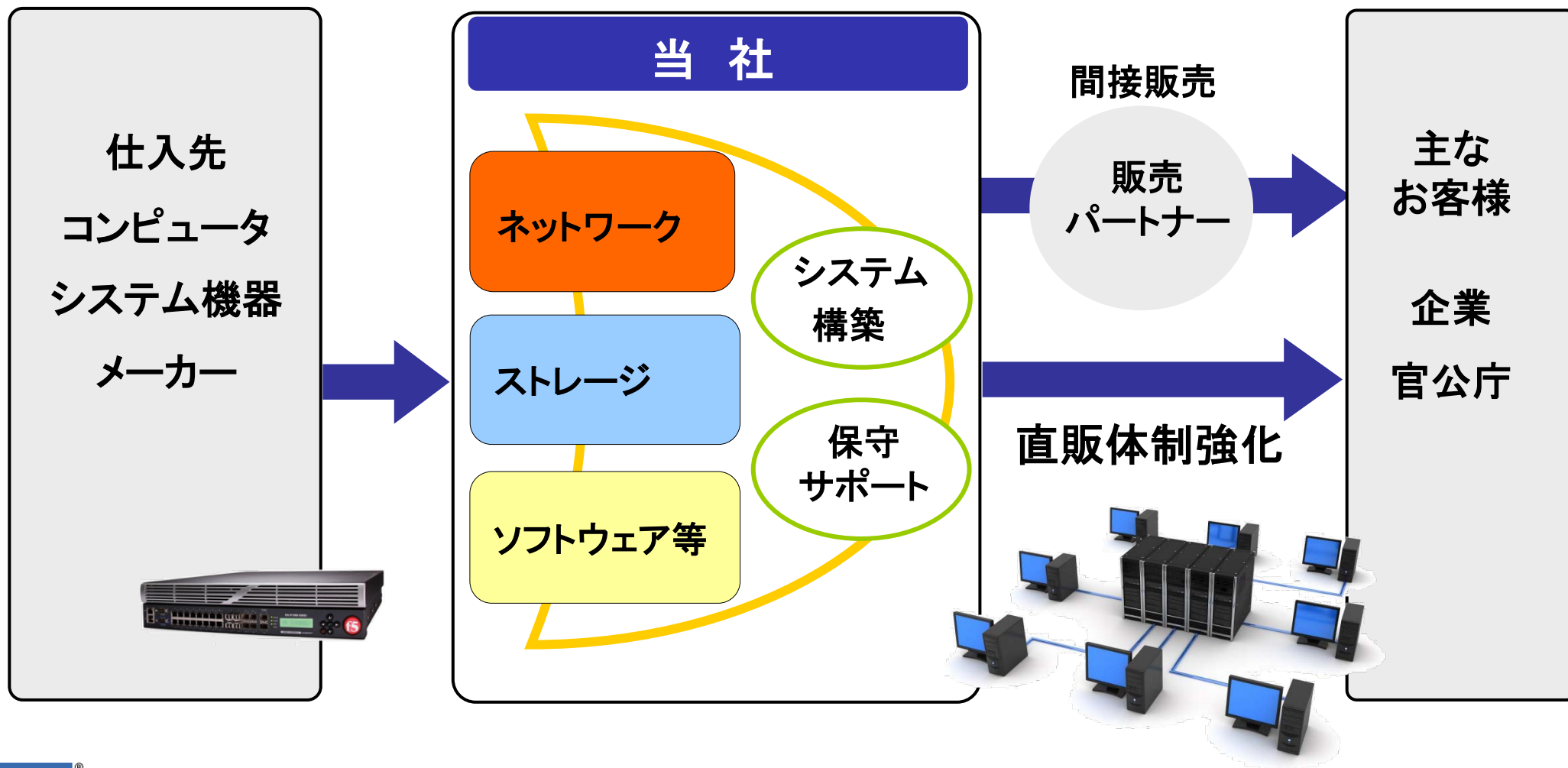


品目別 売上増減要因

品目	主な仕入先	対前年増減率	主な要因
ネットワーク関連	F5ネットワークス	▲12%	保守堅調も官公庁向け減少
ストレージ関連	ブロード アイロン フュージョン・アイオー	31%	企業向け販売堅調 新製品の立ち上がりも寄与
ソフトウェア等	マイクロソフト	9%	産業機器 向け増加

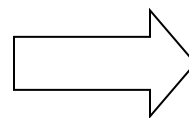
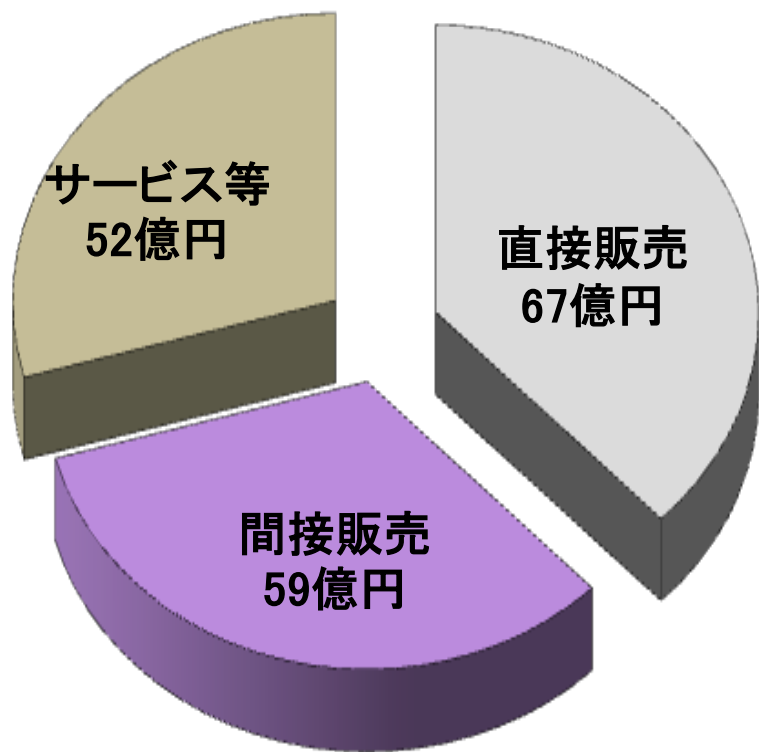
注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

◆ 直販体制を強化



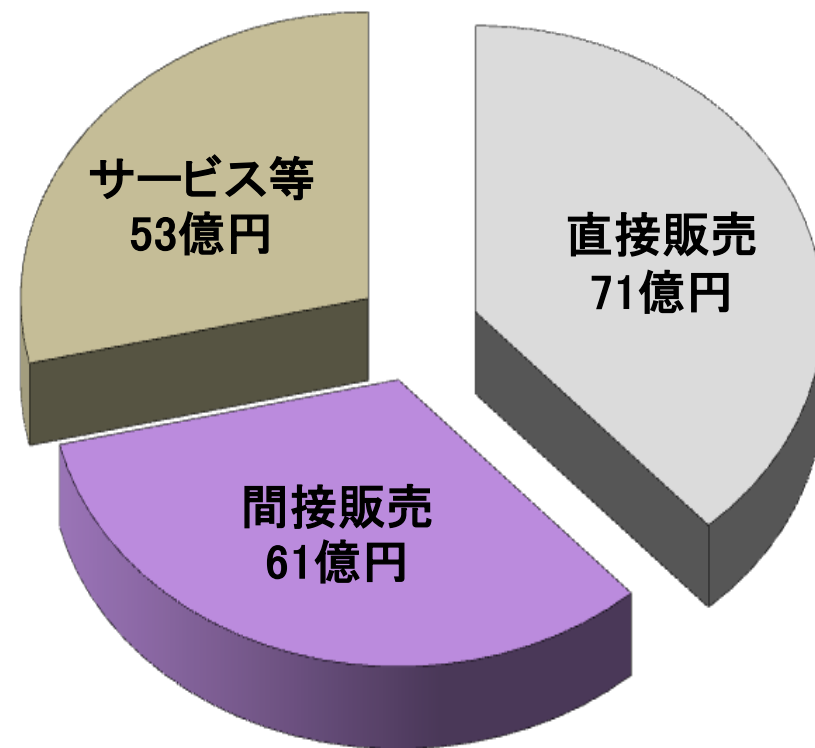
【 2011年3月期 内訳 】

売上高：17,961百万円

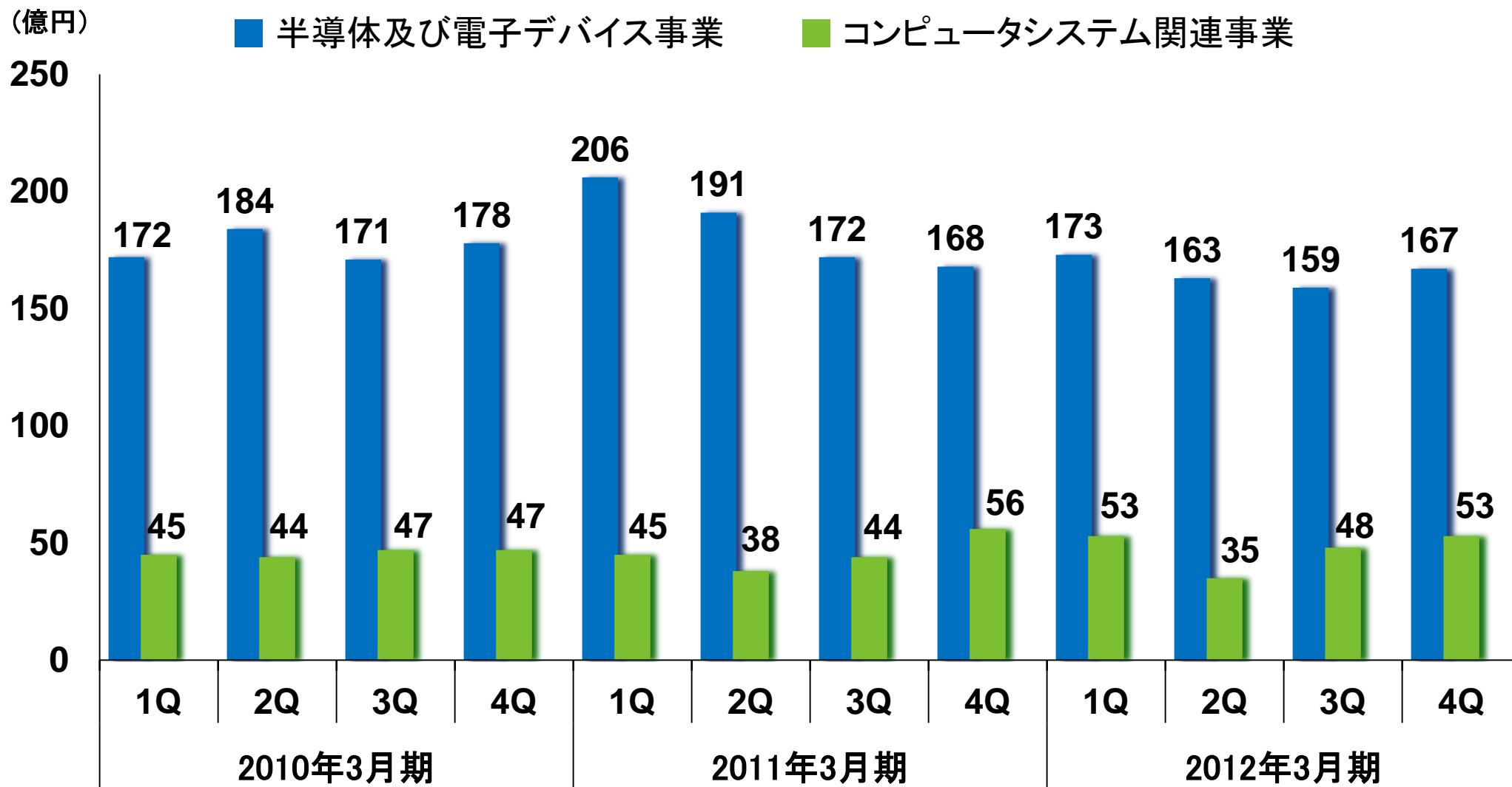


【 2012年3月期 内訳 】

売上高：18,600百万円



受注高推移



- 2013年3月期 業績見込み
- 経営ビジョン及び成長戦略
- 3ヶ年計画
- 配当について
- トピック

代表取締役社長 栗木 康幸

2013年3月期 業績見込み

【半導体及び電子デバイス事業】

国内半導体市場は、緩やかな回復を想定

海外半導体市場は、アジア地域の成長持続を想定

商権拡大等により、下期伸長を計画

【コンピュータシステム関連事業】

クラウドコンピューティングが普及期に入ると想定

企業の国内IT投資は、厳しいながらも回復傾向

2013年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

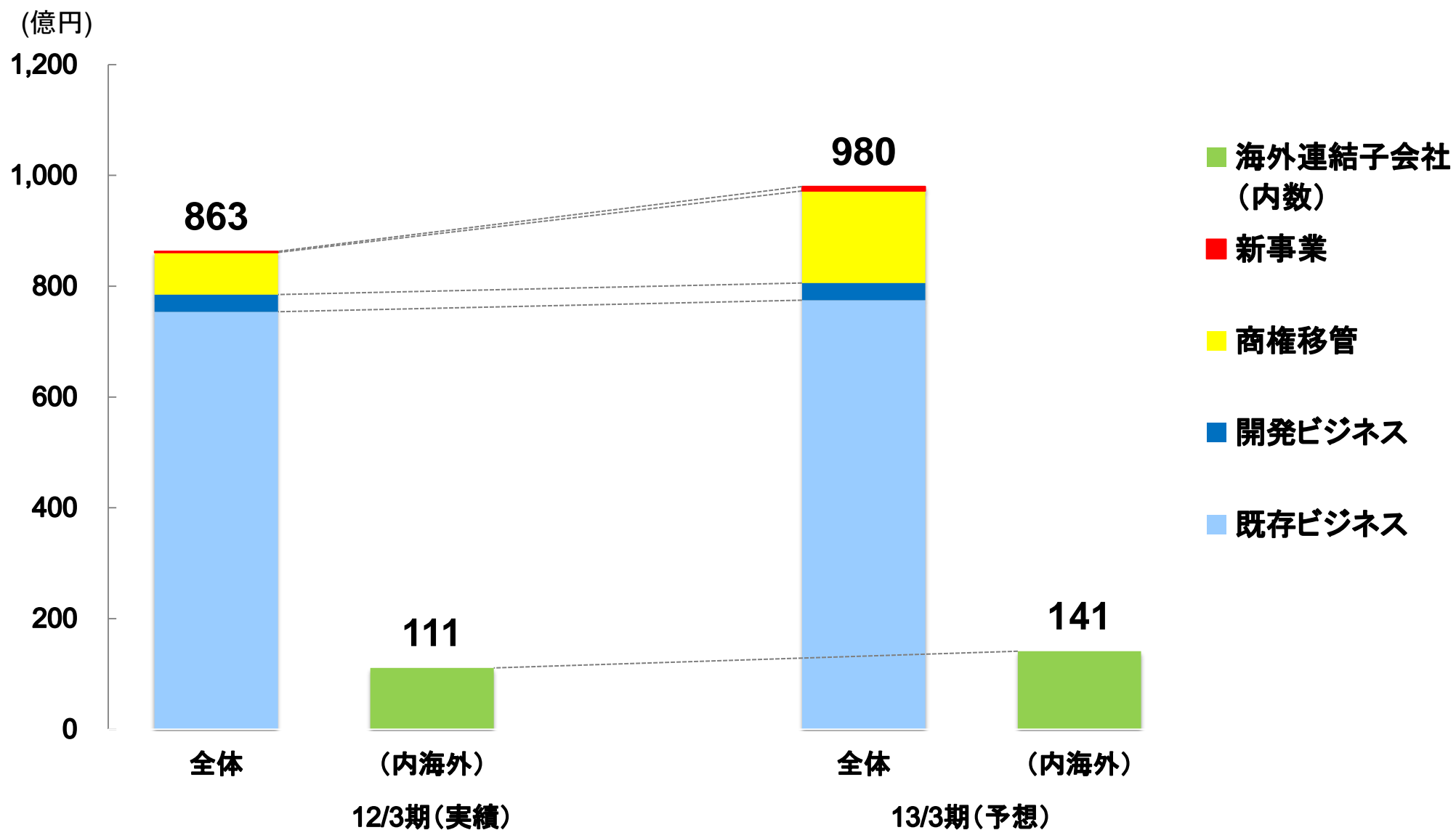
	2012年3月期	2013年3月期			
	通期実績	上期予想	下期予想	通期予想	対前年 増減額増 減率 (%)
売上高	86,300	44,000	54,000	98,000	11,700 13.6
営業利益	2,011	1,000	1,830	2,830	819 40.7
経常利益	2,332	950	1,750	2,700	367 15.7
当期純利益	960	560	1,090	1,650	689 71.7

セグメント別 連結売上高予想

(単位:百万円)

	2012年3月期	2013年3月期			
	通期実績	上期予想	下期予想	通期予想	対前年 増減額 増減率 (%)
半導体及び 電子デバイス事業	67,699	34,770	40,430	75,200	7,500 11.1
コンピュータ システム関連事業	18,600	9,230	13,570	22,800	4,200 22.6
合 計	86,300	44,000	54,000	98,000	11,700 13.6

連結売上高予想 内訳



経営ビジョン及び成長戦略

経営ビジョン

1. お客様、仕入先から絶対的な信頼を得るNo.1技術商社を目指す
2. 企業倫理の徹底
3. 次世代を担う商材と人材の創出
4. 海外事業の促進
5. 新事業への継続的な投資

利益を出し続け拡大していく

株主様への還元

社員の幸福

社会への貢献

お客様の信頼

成長戦略 新商材－1

日付	メーカー名	内容
2012年4月	Digi international社 (半導体)	M2M向けワイヤレスモジュール
2012年 2月	Realtek社 (半導体)	PC、プリンタなどのネットワーク向けIC
2012年 1月	Micropelt社 (新事業)	温度差発電型環境発電
2011年 7月	Powercast社 (新事業)	電波から環境発電
2011年 7月	Nicira Networks社 (コンピュータシステム)	ネットワーク仮想化ソフトウェア
2011年 1月	Fusion-io社 (コンピュータシステム)	ストレージ製品
2010年12月	Memsic社 (半導体)	MEMSセンサ
2010年10月	Semikron社 (半導体)	パワー半導体

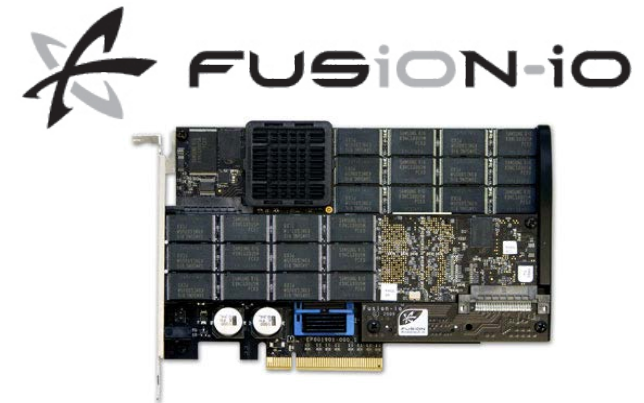
成長戦略 新商材-2

◆クラウド、データセンター向け新製品の投入と発掘

一例

Fusion-io社

データセンターの処理能力を高める
次世代ストレージメモリプラットフォームを開発
米ウォール・ストリート・ジャーナルの
2010年度「新鋭IT企業No.1」を獲得

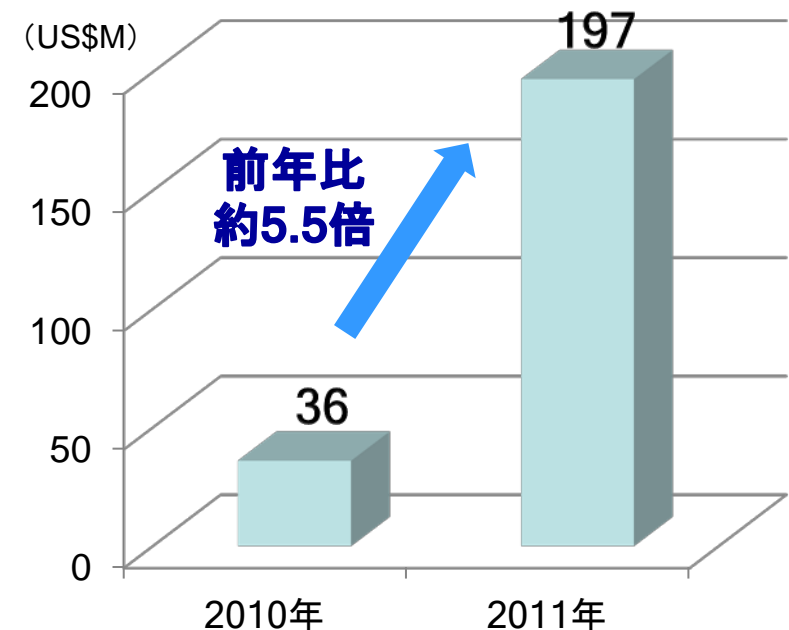


[会社概要]

- ・本社：米国ユタ州ソルトレイク市
- ・設立：2005年
- ・最高経営責任者：デイビッド・フリン
- ・従業員数：440人
- ・ニューヨーク証券取引所上場：2011年6月

(Fusion-io社 ホームページから抜粋)

[売上高]



◆ エナジーハーベスト(環境発電)関連のアプリケーション開発

Micropelt社(マイクロペルト社)

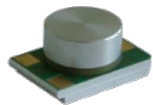
- 排熱から電力再生(電池を不要に)
- 温度差発電デバイス

半導体技術を使って 排熱から数 mWの 電気エネルギー を作り
ワイヤレスセンサを動作させる技術



micropelt
Energy harvesting.

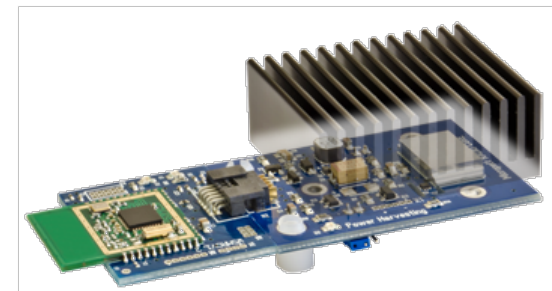
【製品群】



TGP
サーモジェネレータ
パッケージ



TE-CORE /RF:
ワイヤレスセンサ付き
熱電ハーベスティングシステム



TE-CORE
熱電ハーベスティング
パワーモジュール

成長戦略 海外事業－1

◆ 海外売上高比率 半導体事業の30%を目指す

第3ステージ

inrevium

- TED香港をTEDAPACに社名変更
- アジア組織体制を強化
- 自社ブランド商品の海外展開加速
- OEM企業、ODM企業へ販売促進
- 海外現地企業への営業強化

第2ステージ

- アジア地域の拠点を拡充し移管ビジネスを拡大
- 海外現地企業へ自社ブランド商品を販売

第1ステージ

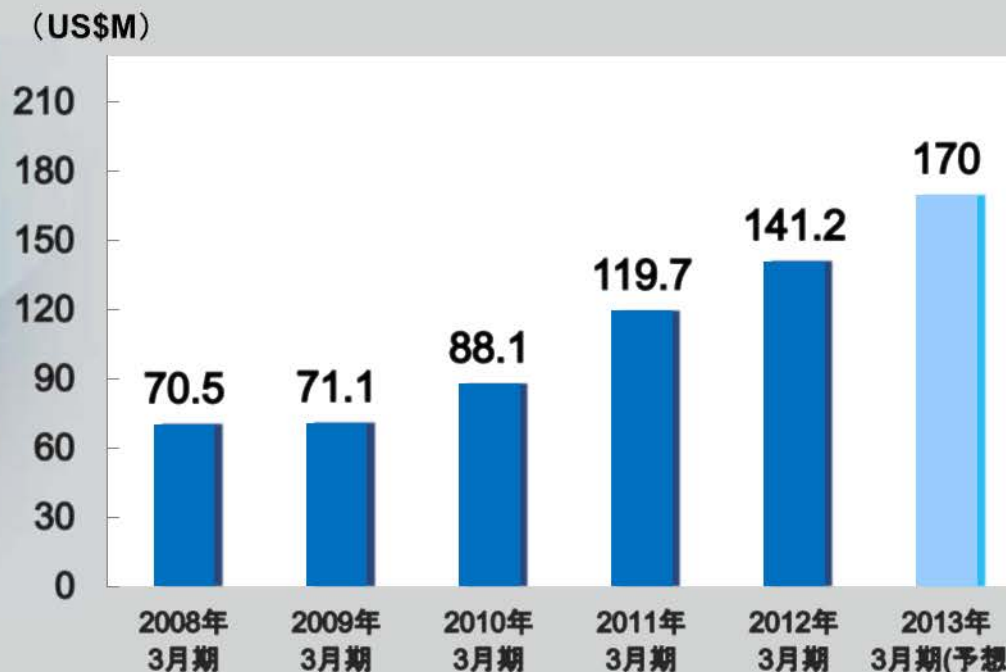
- 有望マーケットであるアジア地域に進出(香港)
- 日系企業に半導体を販売(移管ビジネス)

成長戦略 海外事業-2

- ◆アジア地域に6営業拠点
- ◆上海、無錫に設計開発拠点

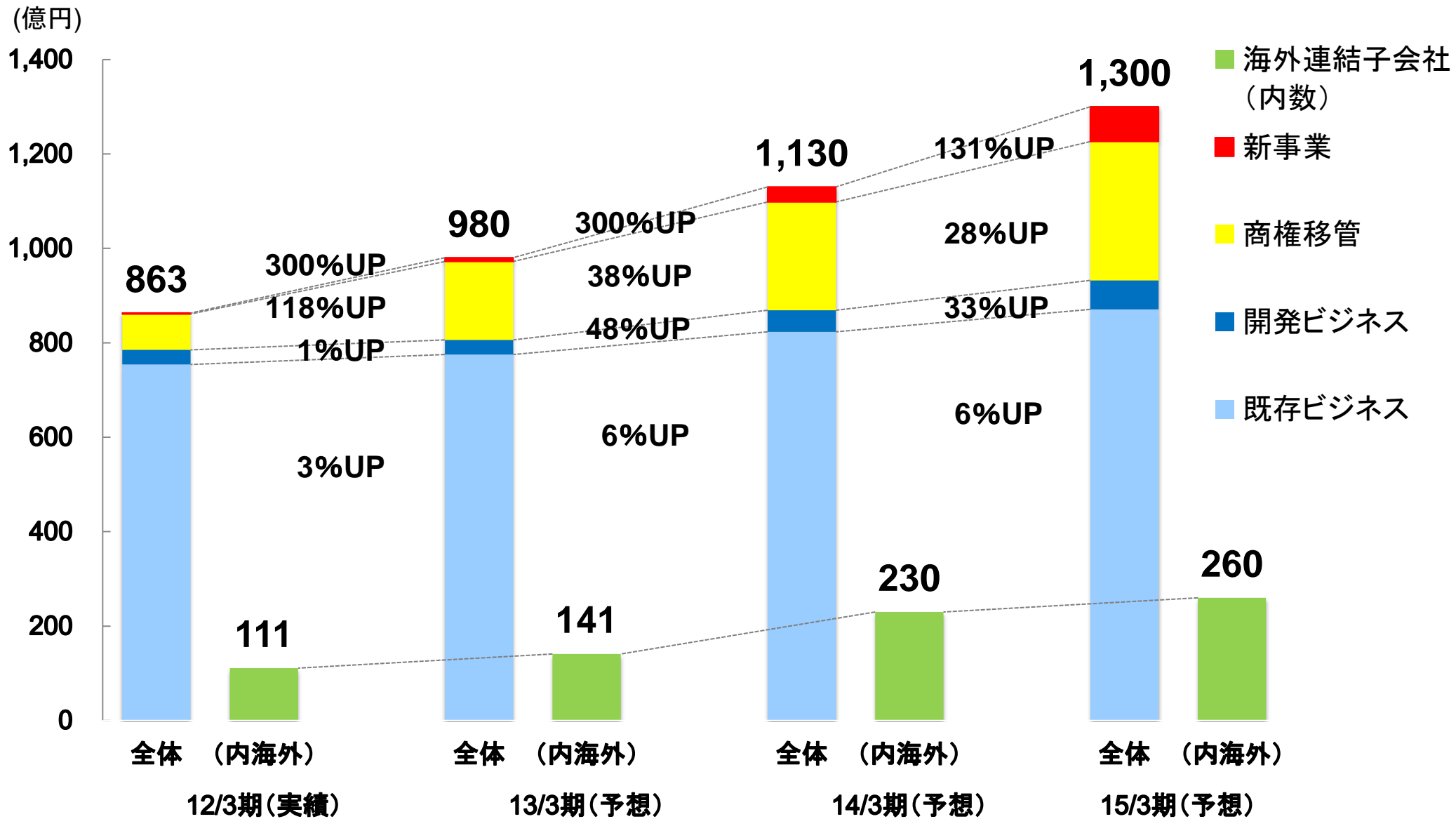
[海外拠点]

[海外連結子会社売上高]



3ヶ年計画

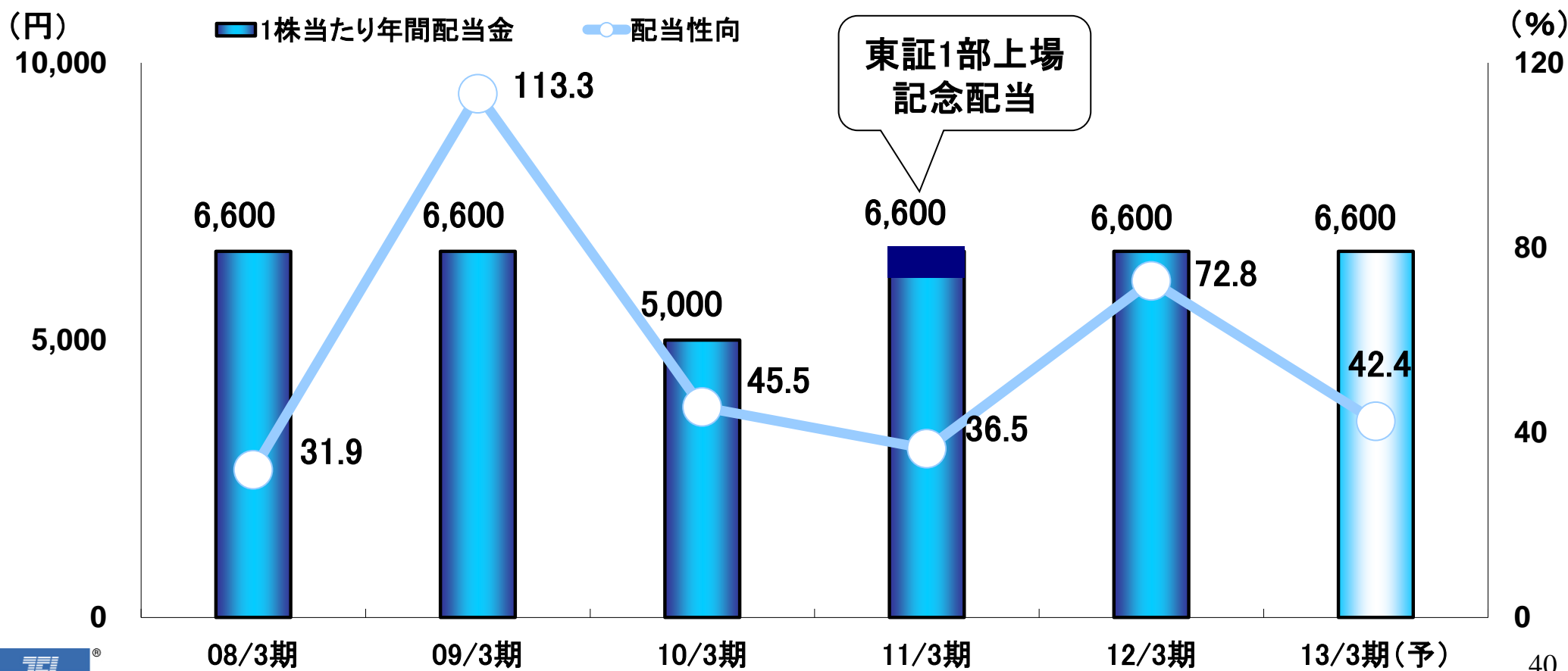
3ヶ年計画



配当について

配当方針

- ◆ 継続的かつ安定的な配当の実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則
- ◆ 当面の配当性向水準：連結当期純利益の35%程度を目安



◆ レスキューロボットコンテストに特別協賛

「技術を学び人と語らい災害に強い世の中をつくる」
というレスキューロボットコンテストの理念に賛同
CSRの一環として今年も特別協賛



第12回 競技会

2012年8月11日(土)、12日(日)
神戸サンボーホールにて開催予定

セグメント・品目		主な仕入先名
半導体及び 電子デバイス事業	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI 社
	カスタムIC	富士通セミコンダクター(株)、サイリンクス社、インビーム
	専用IC	カビウム・ネットワークス社、コネクサントシステムズ社、富士通セミコンダクター(株)、インターシル社、ピクセルワークス社、TI社、シリコンイメージ社、ビクシシステムズ社、サーリンク・セミコンダクター社、インビーム
	CPU	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通セミコンダクター(株)、TI 社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	メモリーIC	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、スパンション社
	個別素子	オン・セミコンダクター社
	電子部品他	コーセル(株)、インビーム
	コンピュータシステム 関連事業	ネットワーク機器
ストレージ関連		ブロード社、EMC社(アイシロン・システムズ、デー外メイン)、フュージョン・アイオー社
ソフトウェア		マイクロソフト社、オラクル社、EMC社(グリーンプラム)

【半導体及び電子デバイス事業】

品目	主な取扱商品	機能
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
カスタムIC	ASIC、PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
メモリーIC	SRAM、フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや読出しのみのものがある
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ボード、電源、コネクタ	プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装した製品(ボード)

【コンピュータシステム関連事業】

ネットワーク関連		インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ) 企業向けネットワークシステム構築機器。
ストレージ関連		SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。
ソフトウェア等		企業の経営効率化を支援するデータウェアハウス エンジン、 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト 社のソフトウェア。

資料取り扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界及びIT業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。

また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

◆本資料に関するお問い合わせ先

東京エレクトロン デバイス株式会社 広報・IR室 秋永

TEL 045-443-4000